



平成 23 年 10 月 7 日

各 位

会 社 名 MUTOH ホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 早川 信正
(コード番号 7999 東証第1部)
問合せ先 経営管理本部 部長 阿部 利彦
(TEL. 03-5740-8700)

当社持分法適用会社(株式会社セコニック)の第三者割当増資の引受けに関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、当社持分法適用会社である株式会社セコニック(東証第2部、コード番号 7758)が第三者割当により発行する新株式のうち 1,000,000 株を引受けることにつき決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 第三者割当により発行される新株式の引受けの目的

当社は、平成22年12月16日に株式会社セコニックの株式2,300,000株を取得し、その後平成23年1月14日に株式会社セコニックと業務提携基本契約を締結し、業務提携の詳細内容等について協議を続けてまいりました。その進捗に基づいて、平成24年3月期第1四半期決算より株式会社セコニックを当社の持分法適用会社といたしております。

今般、円高の加速や東日本大震災の影響など国内の製造業をとりまく環境がますます厳しくなる中で、大判インクジェットプリンタの製造販売を主力事業とする当社と、光学電子情報機器や事務機器等の製造販売を行う株式会社セコニックとは、重要なビジネスパートナーとして、両社が保有する優位性を活かしつつお互いの経営資源を有効活用し、事業領域の継続的な拡大を目指しております。

この方向性を踏まえ、株式会社セコニックの事業基盤の強化と事業拡大を図り、当社と株式会社セコニックの連携をより強固なものとするため、当社は株式会社セコニックの第三者割当増資1,000,000株を引受けるといたしました。

2. 株式会社セコニックの概要

(平成 23 年 6 月 30 日現在)

(1) 名 称	株式会社セコニック	
(2) 所 在 地	東京都練馬区大泉学園町7-24-14	
(3) 代 表 者	代表取締役社長 荒井 宏	
(4) 事 業 内 容	光学電子情報機器、事務機器、電装機材・その他の製造販売	
(5) 資 本 金	1,503 百万円	
(6) 設 立 年 月	1951 年(昭和 26 年)6 月	
(7) 発 行 済 株 式 総 数	16,800,000 株	
(8) 決 算 期	3 月	
(9) 従 業 員 数	790 名(連結)	
(10) 連 結 純 資 産	5,622 百万円	
(11) 連 結 総 資 産	9,777 百万円	
(12) 大株主及び持株比率	MUTOHホールディングス株式会社	13.69%
	TCSホールディングス株式会社	11.90%

(13) 当社との関係	資本関係	当社は間接所有を含め当該会社の株式 2,301,000 株(議決権比率 14.66%)を所有しております。		
	人的関係	当社子会社の取締役1名が、当該会社の取締役を兼任しております。		
	取引関係	記載すべき取引関係はありません。		
	関連当事者への該当状況	当該会社は、当社の持分法適用会社に該当いたします。		
(14) 当該会社の最近3年間の経営成績(連結)				[百万円]
	平成 21 年 3 月 期	平成 22 年 3 月 期	平成 23 年 3 月 期	
売上高	17,358	11,043	12,293	
営業利益	△11	△186	202	
経常利益	△157	△244	168	
当期純利益	△196	△255	71	

3. 株式会社セコニックの第三者割当増資の概要

(1) 発行新株式数	普通株式 2,000,000 株
(2) 発行価格	1株につき 106 円
(3) 発行価格の総額	212,000,000 円
(4) 資本組入額	1株につき 53 円
(5) 資本組入額の総額	106,000,000 円
(6) 払込期日	平成 23 年 10 月 24 日
(7) 割当先及び割当株式数	1. MUTOHホールディングス株式会社 1,000,000 株 2. TCSホールディングス株式会社 1,000,000 株

4. 第三者割当増資の引受け前後の所有株式の状況

	当社直接所有株式数	発行済株式総数に対する割合	大株主順位
異動前	2,300,000 株	13.69%	1 位
異動後	3,300,000 株	17.55%	1 位

5. 第三者割当増資の引受けの日程

平成23年10月 7日(金) 当社取締役会決議
平成23年10月24日(月) 払込期日

6. 業績に与える影響

上記、第三者割当増資の引受けによる業績への影響については、現段階において軽微であると考えておりますが、今後業績の見通しに変更が生じた場合には必要に応じて速やかに公表いたします。

以上